

2026年 1兆ドル規模の 半導体市場がもたらす構造変化

日本経済へのマクロ影響と企業が取るべき戦略的指針

グローバル市場における需要の再編と、国内サプライチェーンにおける「選択と集中」の最適解

エグゼクティブ・サマリー：4つの視座



1. 市場の現実 (Macro Market Reality)

AIインフラ需要により、2026年の世界半導体市場は9,754億ドルへと拡大。「高利益・低数量」の特異な収益構造が定着。



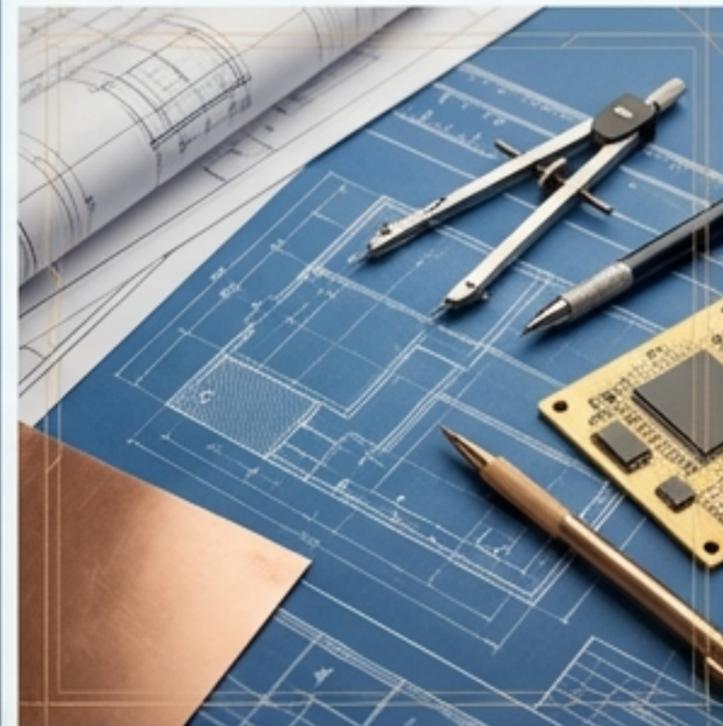
2. 日本経済への影響 (Macroeconomic Impact)

国策支援（最大40%減税等）と民間投資が内需を牽引。一方で、国家間の補助金競争による将来的な供給過剰リスクが内在。



3. 企業群の二極化 (Corporate Ecosystem)

エコシステムの変化により、後工程や素材領域の企業が収益を拡大する一方、レガシー領域の企業は構造改革が急務に。

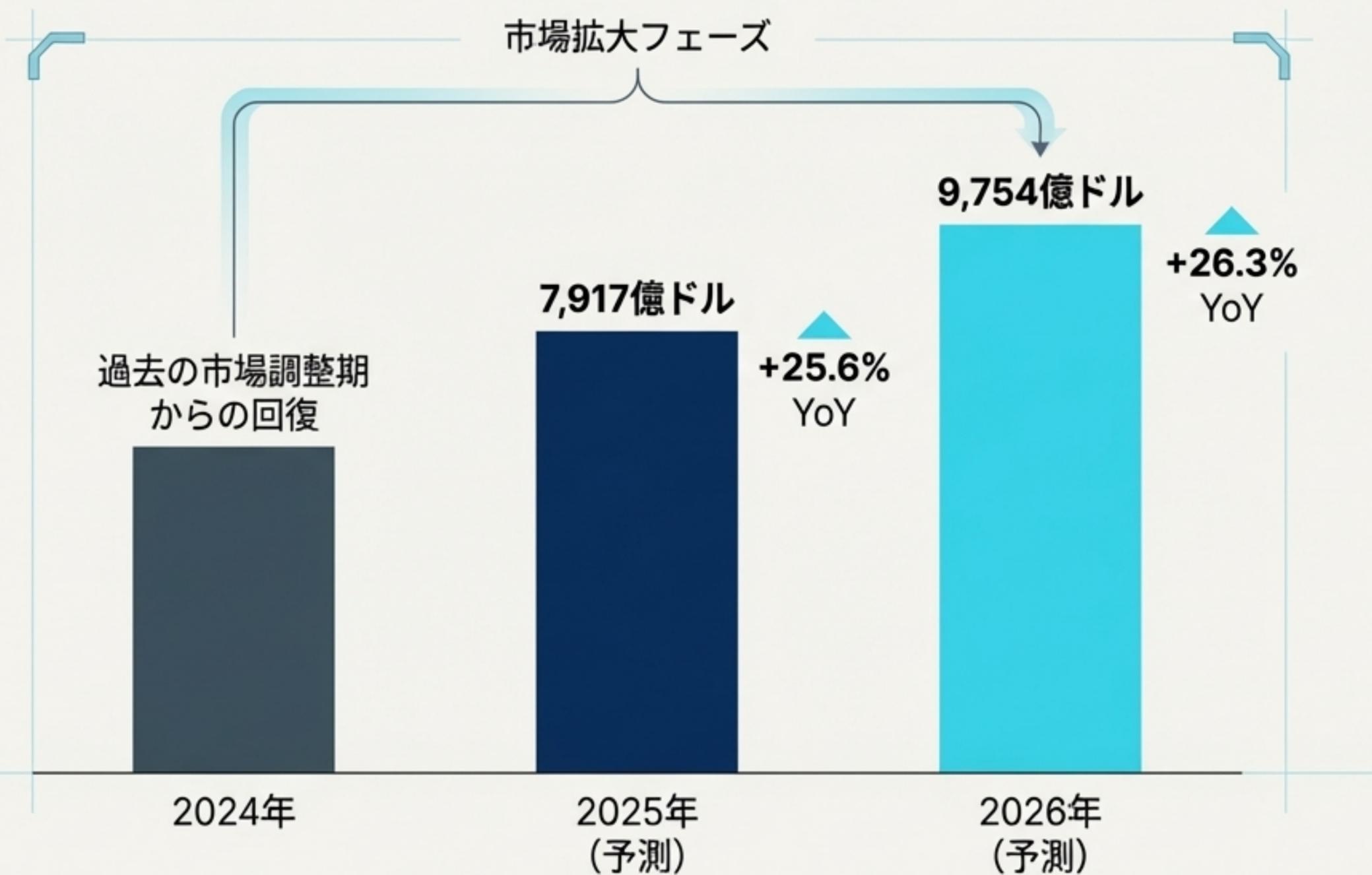


4. 経営の戦略的指針 (Strategic Imperatives)

サプライチェーンの分散、先進進パッケージングへの注力、エッジAI領域での付加価値創出を含む5つの具体的な行動計画。

2026年、市場規模は1兆ドル水準へ接近

AIインフラ投資が市場全体の成長ペースを大幅に前倒ししている。



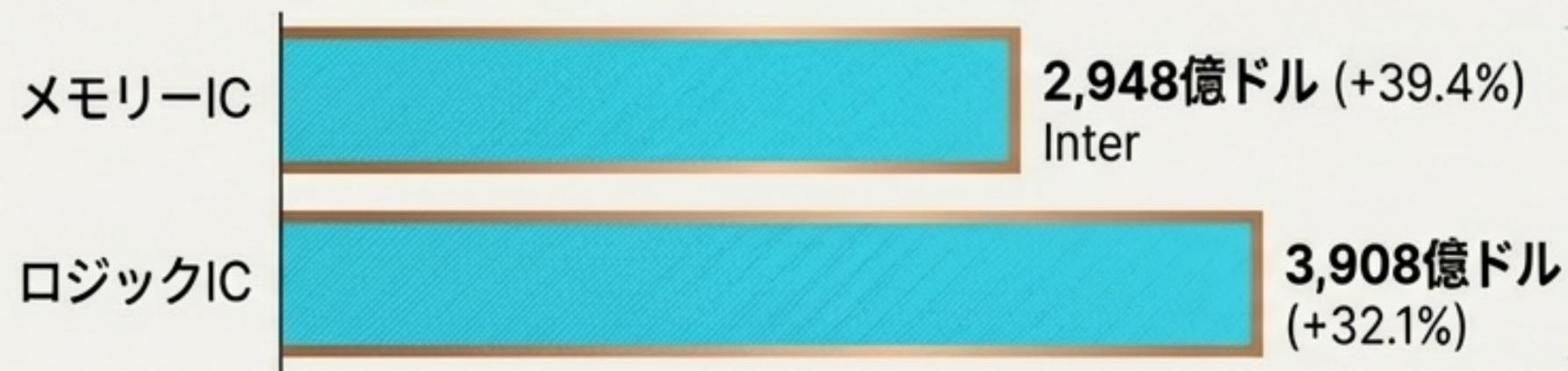
成長のドライバー

AIプラットフォーム構築に向けたハイパースケールデータセンターへの投資が継続。当初2030年と予測されていた1兆ドル到達の時期は、数年前倒しされる見通し (SEMI / WSTS予測に基づく)。

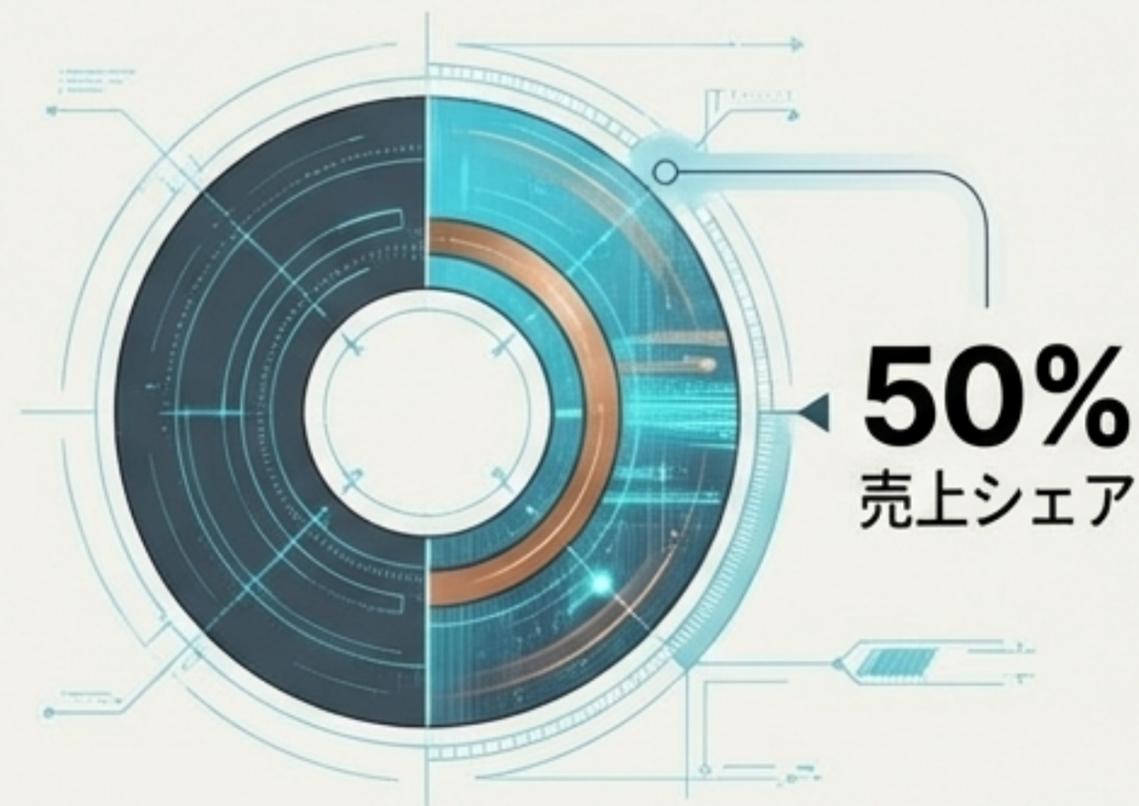
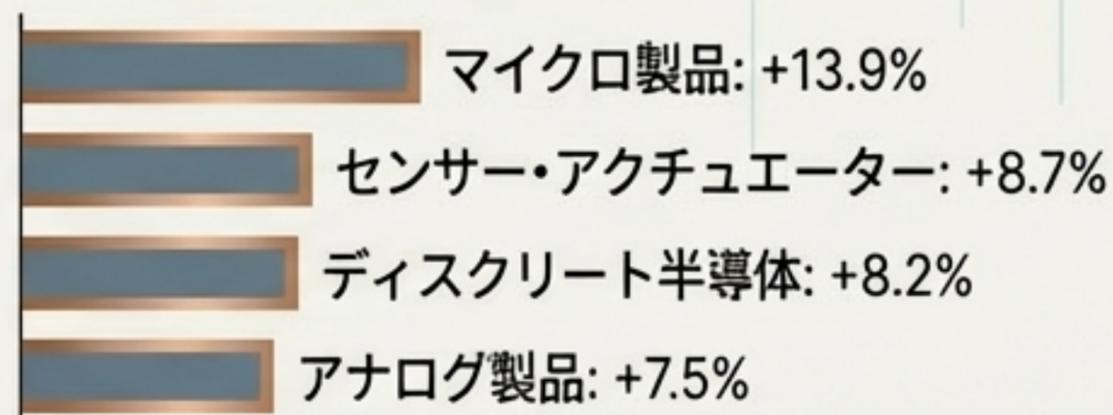
製品カテゴリー間の成長乖離：演算と記憶への集中

需要は全領域で均等に拡大しているわけではなく、特定の領域に顕著に集中している。

高成長領域（2026年予測）



安定・低成長領域



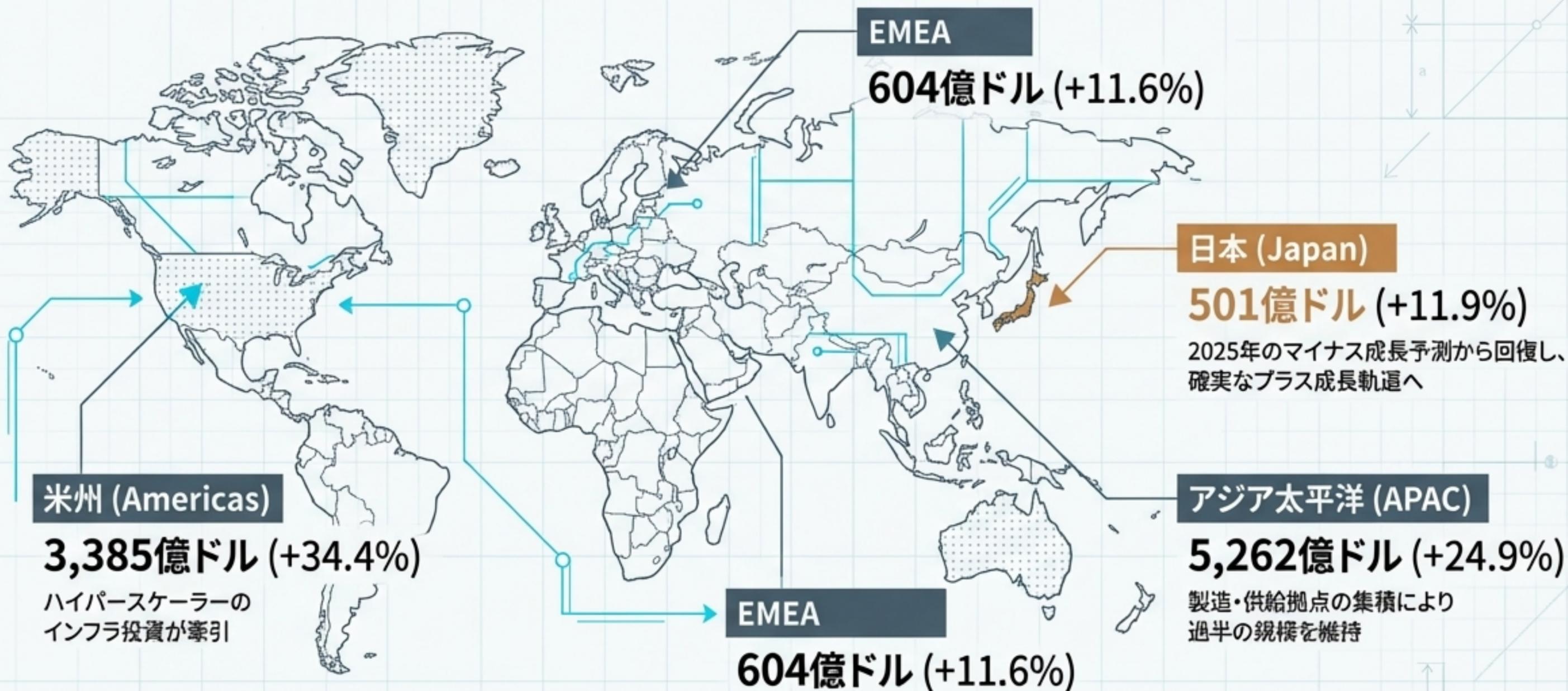
高マージン・ 低ボリュームの構造



AIチップは市場全体の売上の約50%を占める規模に成長しているが、出荷数量ベースでは全体の0.2%未満に留まる。

地域別成長予測と日本市場の位置づけ

巨大IT企業が集中する米州が成長を牽引し、日本市場もプラス成長へ転じる。



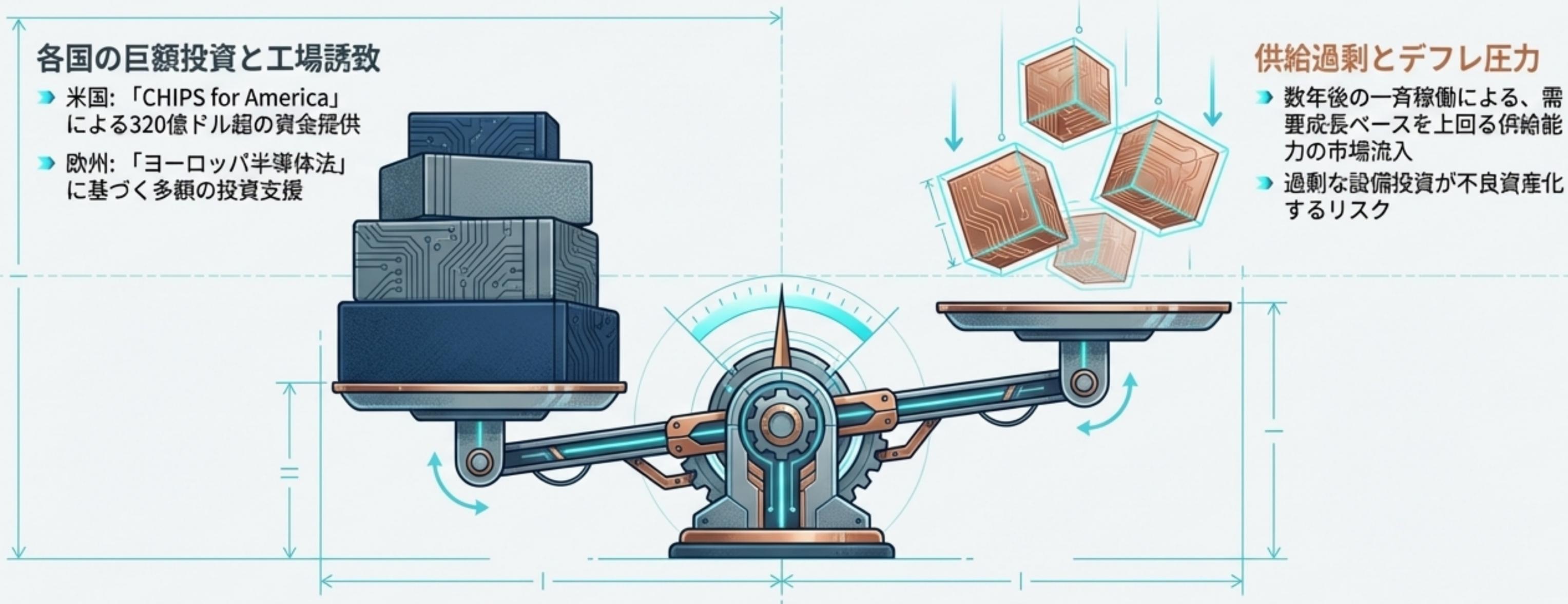
日本経済への波及効果：国策支援と巨額投資

政府の強力な支援策が呼び水となり、国内の生産基盤強化が進んでいる。



マクロ経済の潜在的リスク：「官製不況」の懸念

国家主導の投資競争は、中長期的な供給過剰リスクを内包している。

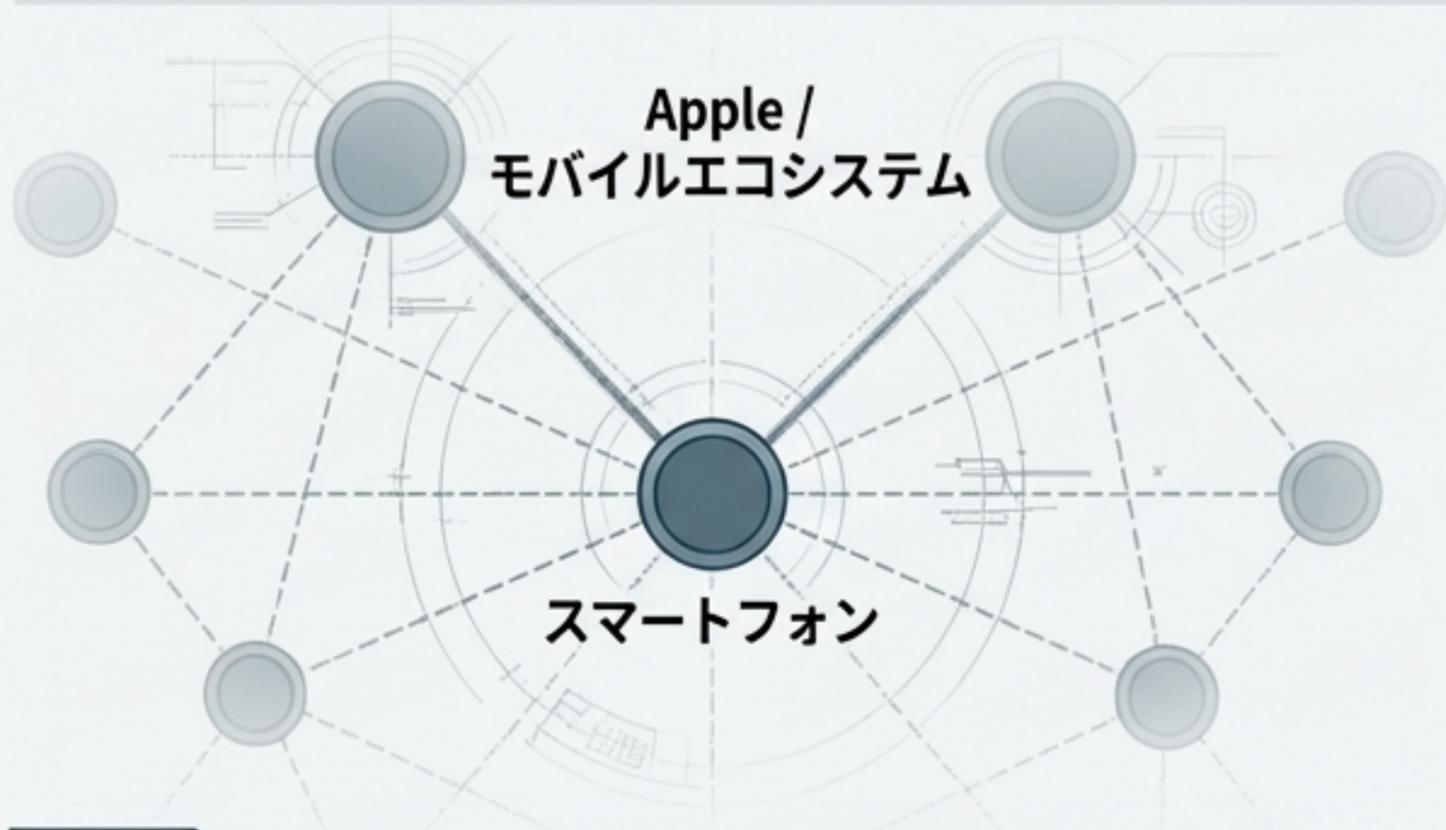


過去のメモリー市場における価格下落の歴史的教訓を踏まえ、投資と需要のバランスを見極める冷徹な分析が必要である。

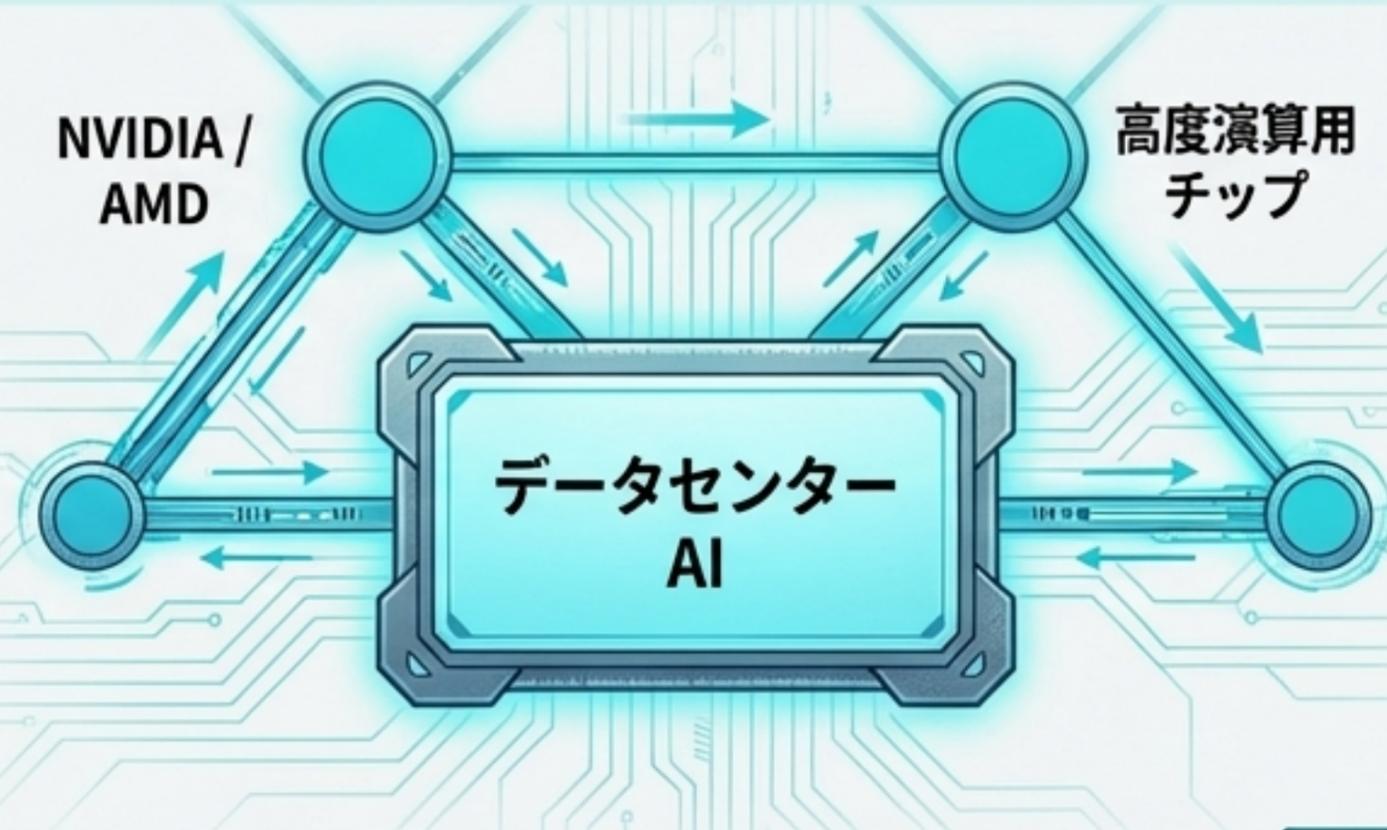
サプライチェーンの重心移動

エコシステムの最優先顧客が移行し、供給網の覇権構造が変化している。

従来の構造: スマートフォン中心のモバイル機器向けサプライチェーンが市場を主導。



現在の構造: NVIDIAやAMD等の高度演算用チップを手掛ける企業への優先度が上昇。



ビジネスの軸足移行

日本企業は、最終製品の市場シェアに依存するモデルから、データセンター・AIインフラを中心としたサプライチェーンへと迅速に適応することが求められる。

企業群の二極化：環境変化への適応状況

AI需要へのシフトに対する適応スピードが、企業の収益構造に明確な差異をもたらしている。

【価値創造領域：チョークポイントの確保】

住友ベークライト：封止材の需要拡大。2026年3月期純利益 純利益見通しを**255億円**へ上方修正。

日東紡：熱膨張を抑える特殊ガラス「Tガラス」（世界シェア**約9割**）。**約150億円**の投資で生産能力を最大**3倍**へ。

マルマエ：超高純度アルミニウム部品。**月産140トン**へ**倍増**させ、2030年に売上高**300億円**を目標。

【構造改革領域：ポートフォリオの再編】

ルネサスエレクトロニクス：EV需要の減速等により**690億円の最終赤字**。非中核事業を**約4,700億円**で売却し、経営資源を再集中。

村田製作所：サーバー向け需要は堅調なもの、過去の買収関連の**減損処理**（**約438億円**）により営業利益が**50.2%減少**。

社会インフラと消費者への波及効果

AIインフラ投資への生産能力集中は、日常生活と社会インフラの双方に影響を及ぼしている。



メモリー・ショックと製品価格への転嫁

- HBM（広帯域メモリー）の最優先生産: 利益率の高いAIサーバー向けメモリーの増産が、製造ラインを占有。
- 汎用DRAMの供給不足: 生産枠の圧迫により、次世代スマートフォン等のコンシューマー製品の製造原価が上昇。



社会実装によるインフラの高度化

- モビリティの変革: ソフトウェア定義型車両（SDV）や高度な自動運転技術の基盤確立。
- 物流・都市インフラ: 膨大なデータのリアルタイム処理による次世代物流システムとスマートシティの実現。

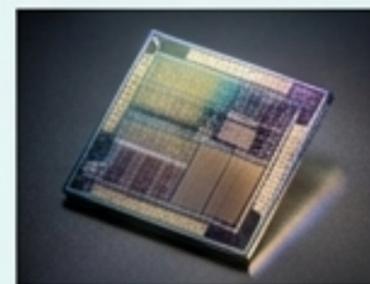
GX（グリーントランスフォーメーション）と持続可能性への寄与

データセンターの巨大化に伴う電力消費の増大に対し、エネルギー効率の極限的な向上が求められている。



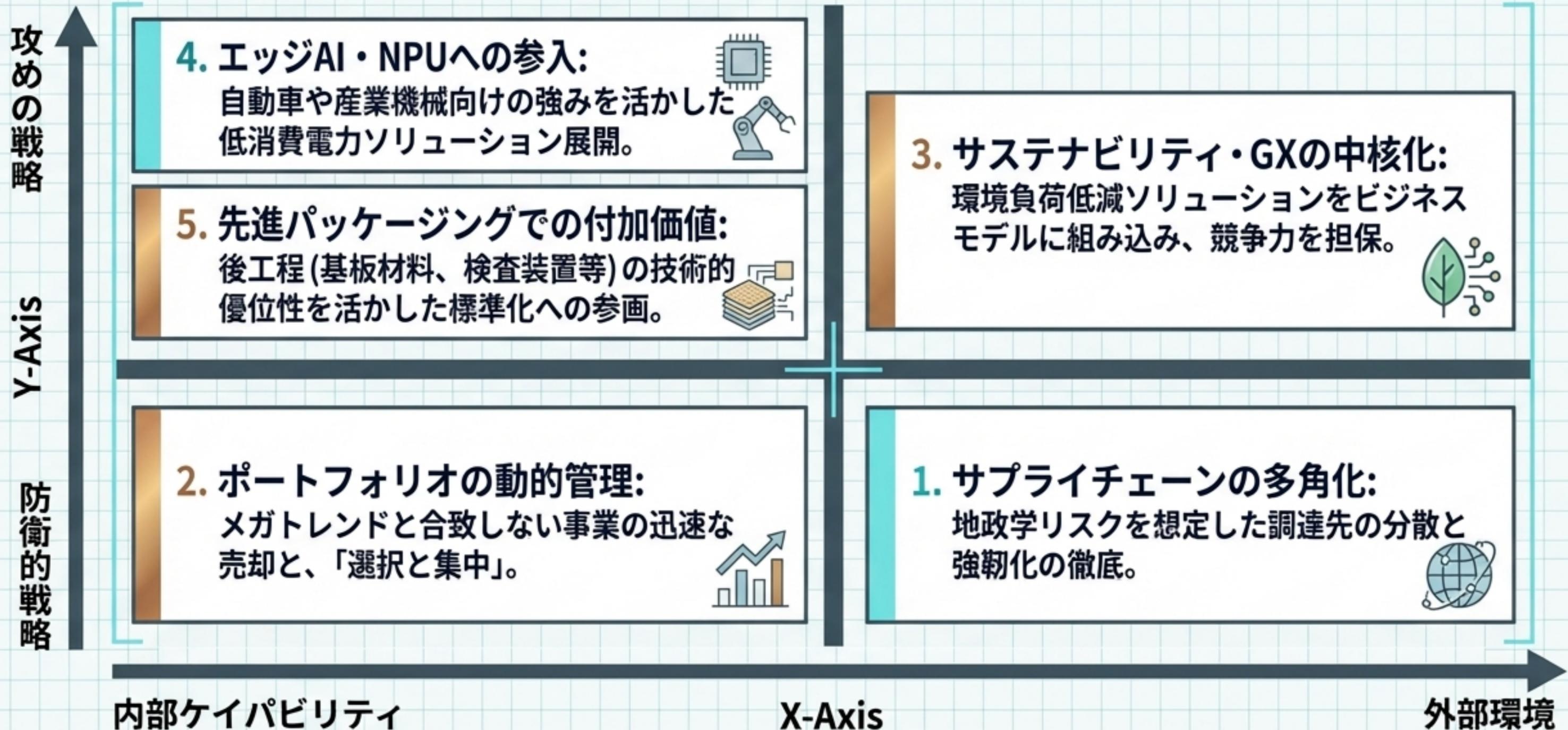
次世代技術の共同開発

ソフトバンク子会社（SAIMEMORY）と米Intelによる次世代低電力メモリ「ZAM」の開発。2029年度の実用化を見据え、消費電力の劇的な削減を目指す。



経営層が取るべき5つの戦略的指針

環境変化に適応し、中長期的な競争優位性を確立するための事業戦略。



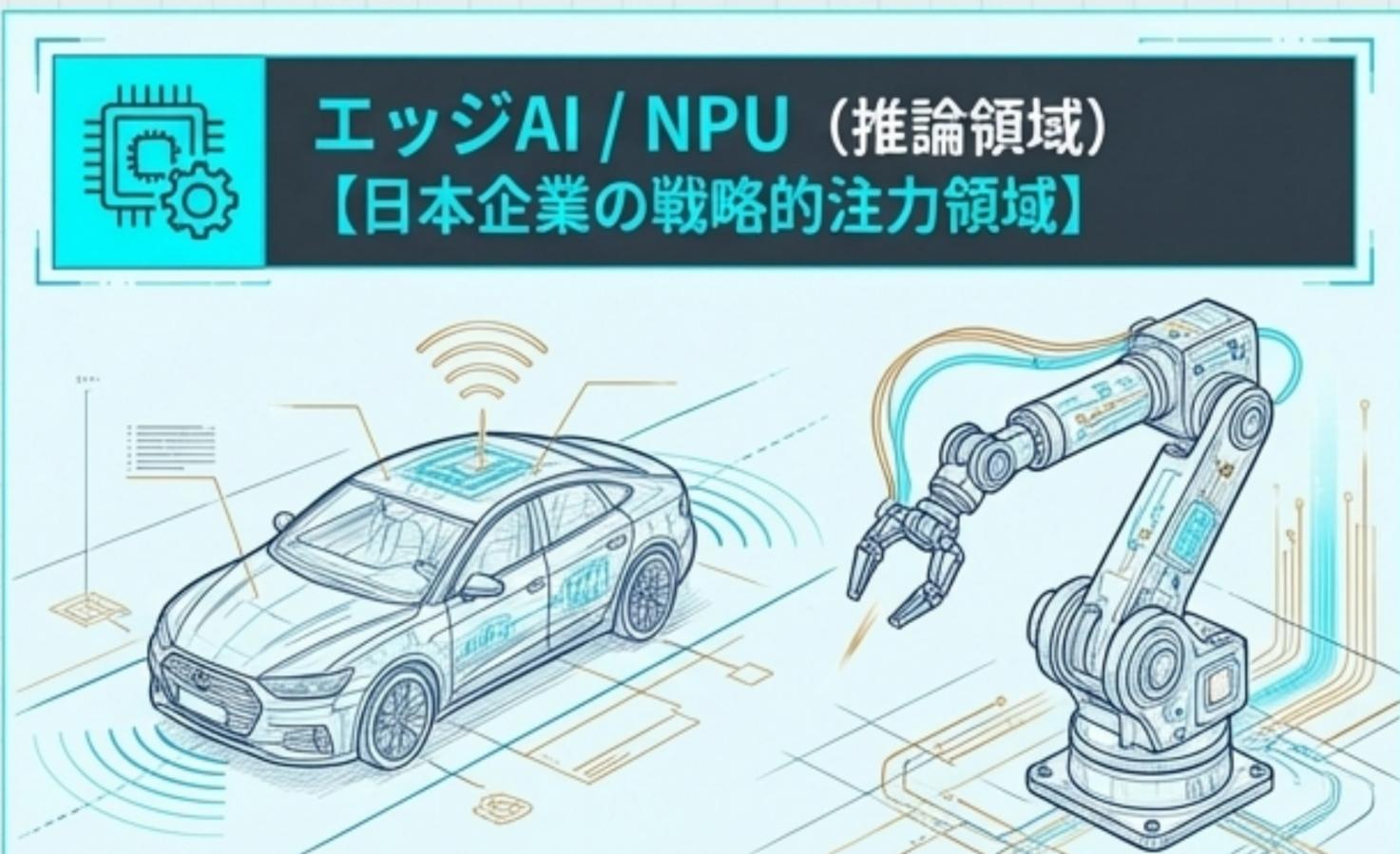
戦略領域の深掘り：エッジAI市場への注力

最先端ロジック半導体の製造で真正面から競合するのではなく、既存の強みを応用できる領域へ資源を集中させる。



クラウドAI (学習領域)

- ハイパースケールデータセンター向け
- 米国および台湾企業が支配的なシェアを確立
- 巨額の資本投下と微細化競争が前提

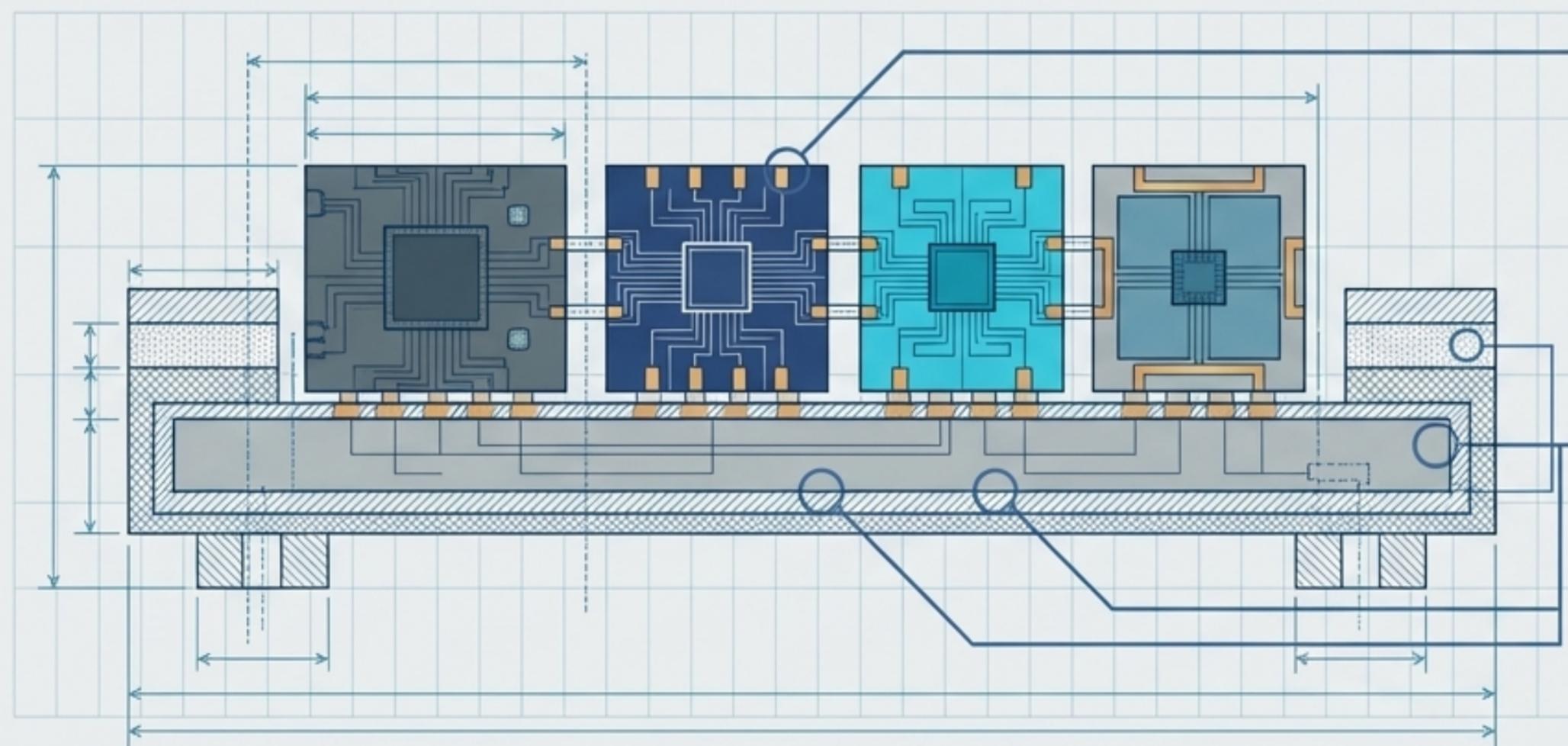


エッジAI / NPU (推論領域) 【日本企業の戦略的注力領域】

- 自動車 (SDV)、産業用ロボット、IoT機器の端末側での処理
- 日本企業が得意とするマイコン技術の応用が可能
- 特定用途向けに最適化された低消費電力アーキテクチャで高収益なニッチ市場を形成

戦略領域の深掘り：先進パッケージングと「関所」の確保

微細化の物理的限界により、業界の競争軸はチップの設計アーキテクチャと「後工程」へと移行している。



○ チップレット・アーキテクチャ：
複数の異なる小規模チップを一つの
基板上に統合し、システムレベル
での最適化を図る技術。

○ 日本の優位性（チョークポイント）：
・ 基板材料
・ 熱放射・封止材技術
・ 高精度な検査装置

素材および製造装置分野における圧倒的な世界シェアを活用し、トップファウンドリの
初期開発段階から参画することで、次世代技術の標準化を牽引する。

結論：次世代エコシステムにおける不可欠なポジションの確立

2026年の1兆ドル市場は、単なる規模の拡大ではなく、産業構造と供給網の抜本的な再定義を意味している。

- 需要偏重による価格変動や官製不況（供給過剰）のリスクを客観的に見極めること。
- エッジAIや先進パッケージングといった新たな付加価値領域へ経営資源を集中させること。
- 地政学的リスクへの耐性と環境負荷低減（GX）を両立させる高度な事業戦略を実行すること。

データと演算能力が全産業の基盤となる時代において、半導体サプライチェーン内の「不可欠な関所」を確保し続けることが、今後の持続的な成長を決定づける。